

第94回レーザー加工学会講演会 (Webカンファレンス) <予告プログラム>

1日目 2020年11月26日(木)

9:20	開会の辞 (レーザー加工学会会長 森 清和 (神奈川県立産業技術総合研究所))			
<b>26A0 基調講演 (座長：白井 秀彰 (デンソー))</b>				
9:30	中部から発信するレーザー加工応用の新潮流		瀧口 義浩 (光産業創成大学院大学 学長)	
10:20	ジャイアントパルスマイクロチップレーザーによるエンジン点火 (仮題)		平等 拓範 (理化学研究所/分子科学研究所)	
11:10	<b>26Pn ポスターセッション①</b> ・ビデオ告知 (11:10~11:20, 各90秒) ・ポスターセッション(各会議室に分かれて90分：11:20~12:50) /昼食休憩も兼ねる P1：ワット級高出力中赤外量子カスケードレーザー光源の開発及び樹脂加工への応用 秋草 直大 (浜松ホトニクス) P2：超短パルスレーザー誘起表面構造による金属の撥水性の改善 渡邊 巧 (信州大学) P3：SiC/SiC CMCの加速加熱試験に向けたSelective Laser Thermoregulation(SLT)法の開発 越地 駿人 (東京工科大学) P4：異種金属のレーザー接合工法 汲田 敏章 (住友重機械工業)			
12:50	休憩 (10分)			
<b>26A1 先端ビーム制御と光源 (座長：渡辺 俊哉 (三菱重工業))</b>			<b>26B1 表面改質技術の応用 (座長：田中 健一郎 (パナソニック))</b>	
13:00	【受賞講演】 マルチレーザービーム照射法によるレーザークラディング技術に関する研究	浅野 孝平 (ヤマザキマザック)	13:00	広域パラメータ可変超短パルスレーザー加工による高速パラメータ探索 奈良崎 愛子 (産業技術総合研究所)
13:30	10kW級レーザー加工用 ビーム成形デバイスの開発	赤毛 勇一 (日本電信電話)	13:30	中赤外 Er ファイバーレーザーによるレーザー加工技術 小田 晃一 (三星ダイヤモンド工業)
14:00	グリーンレーザーおよびビームプロファイル制御技術BrightLine Weldによる鋼の高品質溶接	中村 強 (トルンプ)	14:00	GHzバーストモードフェムト秒レーザー加工 小幡 孝太郎 (理化学研究所)
14:30	nLIGHT社オールファイバー構造ビーム可変ファイバーレーザーの特長と加工への効果	木下 真寛 (丸文)	14:30	後方パルスレーザー堆積法におけるニッケル表面へのナノ柱状構造体形成技術 神田 和暉 (デンソー)
15:00	WEB展示のビデオ告知 (司会から) Max 20分		15:00	WEB展示のビデオ告知 (司会から) Max 20分
15:20	休憩			
15:25	<b>26Em WEB展示① 個別の各会議室</b> 26E1:株式会社レーザーライン, 26E2:前田工業株式会社, 26E3:株式会社リプス・ワークス, 26E4:パルステック工業株式会社, 26E5:トルンプ株式会社, 26E6:ビーム株式会社, 26E7:株式会社プロフィテット, 26E8:パナソニック株式会社 IS社 産業デバイスソリューション営業統括部, 26E9:愛知産業株式会社, 26E10:レーザーックス株式会社, 26E11:株式会社アマダウエルドテック, 26E12:光産業創成大学院大学, 26E13:IPGフォトニクスジャパン株式会社, 26E14:丸文株式会社, 26E15:住友重機械工業株式会社, 26E16:株式会社進和			
16:25	休憩			
<b>26A2 レーザ加工現象理解と応用 (座長：柳井 大志 (日産自動車))</b>			<b>26B2 微細加工 (座長：佐藤雄二 (大阪大学))</b>	
16:30	機械学習によるレーザー粉体肉盛り溶接の粉末組成と加工条件の推奨	森 清和 (神奈川県立産業技術総合研究所)	16:30	【受賞講演】 ステルスダイニングによる微細加工技術の変遷と展望 —24時間稼働できる高スループットレーザー加工装置— 久野 耕司 (浜松ホトニクス)
17:00	レーザー溶接のCPS化への取り組み	坂井 哲男(東芝)	17:00	極微細レーザーマーカー, パルス/CWレーザークリーナー, 加工用UVフェムト秒レーザー光源開発の挑戦 住村 和彦 (光響)
17:30	インラインモニタリングの最新技術とその応用	菊地 淳史 (IPGフォトニクス・ジャパン)	17:30	短パルスレーザーによる微細穴加工技術とその適用事例 今宮 悠治 (三菱重工工作機械)
18:00	1日目 終了			

弊社 / 公演詳細 (弊社代表 住村)

第94回レーザー加工学会講演会 (Webカンファレンス) <予告プログラム>

2日目 2020年11月27日(金)

27A0 地域セッション (座長：三瓶和久 (タマリ工業))					
10:00	高速干渉計測によるレーザー加工現象の可視化	石井 勝弘 (光産業創成大学院大学)			
10:40	三菱電機における最新レーザー切断技術	井上 孝 (三菱電機)			
11:20	自動車部品におけるレーザー適用と最近の進歩	白井 秀彰 (デンソー)			
12:00	昼休み/ WEB展示のビデオ告知				
13:00	<p style="text-align: center;"><b>27Em WEB展示② 個別の各会議室</b></p> <p>27E1:株式会社レーザーライン, 27E2:前田工業株式会社, 27E3:株式会社リプス・ワークス, 27E4:バルステック工業株式会社, 27E5:トルンプ株式会社, 27E6:ビーム株式会社, 27E7:株式会社プロフィテット, 27E8:パナソニック株式会社 IS社 産業デバイスソリューション営業統括部, 27E9:愛知産業株式会社, 27E10:レーザックス株式会社, 27E11:株式会社アマダウエルドテック, 27E12:光産業創成大学院大学, 27E13:IPGフォトニクスジャパン株式会社, 27E14:丸文株式会社, 27E15:住友重機械工業株式会社, 27E16:株式会社進和</p>				
14:00	休憩				
27A1 ブルーレーザーの産業応用 (座長：白井秀彰 (デンソー))		27B1 微細穴あけ加工の新展開 (座長：岡本康寛 (岡山大学))			
14:20	【特別講演】新型コロナウイルス禍、青色半導体レーザーが拓く未来 –スマートカントリー構想「人にやさしく人が集まれる まちづくり」–	塚本 雅裕 (大阪大学)	14:20	【特別講演】偏光ビームによる異形穴加工	菊田 久雄 (大阪府立大学)
15:00	Blue- IRハイブリッドレーザーによる高品質銅加工	金子 昌充 (古河電気工業)	15:00	強く集光したベクトルビームによる微細穴あけ加工	小澤 祐市 (東北大学)
15:30	高品質な車載用電池を実現する先端レーザー技術	千園 達郎 (UW JAPAN)	15:30	過渡選択的光吸収によるガラスの超高速微細精密レーザー加工	伊藤 佑介 (東京大学)
16:00	キロワット級ブルー半導体レーザー及びダイレクトLD発振器の開発動向とその応用	Markus Rütering (Laserline GmbH)	16:00	深層学習による補償光学を用いたフェムト秒レーザー加工	長谷川 智士 (宇都宮大学)
16:30	終了				

\*時間、内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。